

職能單元代碼	MPM3R2854v2
職能單元名稱	電子樣品組裝、測試及調校
職類別	製造 / 生產管理
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	<p>一、樣品組裝</p> <p>1. 協助電子工程人員，依據電子電路設計圖、印刷電路板設計圖、韌體程式、機構設計圖及產品設計說明書，完成樣品製作與組裝。</p> <p>二、樣品測試及調校</p> <p>1. 協助電子工程人員指導，執行樣品測試、調校及故障檢修。</p> <p>2. 協助電子工程人員，依據設計文件連結樣品與周邊設備。</p>
工作產出	<ul style="list-style-type: none"> • 故障紀錄表 • 樣品測試紀錄表
職能內涵 (K=knowledge知識)	<ul style="list-style-type: none"> • 軟體與韌體程式 • 職業安全衛生相關規範 • 信號與邏輯分析概論 • 類比與數位邏輯電路概論 • 電子電路概論 • 電子電路識圖 • 電子產品規格 • 周邊硬體設備 • 嵌入式系統概論
職能內涵 (S=skills技能)	<ul style="list-style-type: none"> • 作業系統操作能力 • 電子零件與儀器管理能力 • 專業語文術語溝通協調能力 • 電子電路組裝與測試能力 • 電子電路繪圖能力 • 電源與測試儀器操作能力 • 程式軟體測試能力 • 設備清潔保養能力 • 文書處理能力

	• 周邊硬體設備安裝能力
說明與補充事項	無